

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	德邦证券（7月4日） 平安基金（7月8日） 中金公司（7月12日） 奇点资本（7月12日） 山高国际资管（7月12日） 广发证券（7月13日） 杉树资产（7月13日） 淡马锡（7月13日） 方圆基金（7月13日） 中信证券（7月14日） 广发证券（7月14日） 盈峰资本（7月14日）
时间	2022年7月4日-2022年7月14日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司整体概况</p> <p>公司自成立以来一直专注于PCB行业，通过二十年的技术沉淀，完成了从单一产品(机械钻孔机)拓展到现在覆盖钻孔、曝光、成型、检测等PCB加工多个关键工序的产品布局，产品广泛覆盖多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个PCB细分领域。</p> <p>公司在PCB关键工序加工设备中不断累积经验，取得较为显著的成</p>

就。公司连续十三年（2009~2021）获得CPCA发布的中国电子电路行业百强排行榜专用仪器和设备类排名榜首，2019-2021年连续三年获得国内PCB龙头企业深南电路（002916.SZ）“金牌供应商”（设备类企业唯一）称号。

公司将继续保持与上游关键器件供应商及下游龙头PCB制造商紧密合作，以实时掌握行业内领先的生产技术和工艺变化趋势，构建起产业链上中下游一体化的研发联动机制。另一方面，公司也将深入挖掘高速高精运动控制、精密机械、电气工程、软件算法、先进光学系统、激光技术、图像处理、电子测试八类关键技术，持续推出满足下游客户工艺需求的工序解决方案。

现阶段，多层板市场的机械钻孔设备、LDI、电测设备仍是公司的主要收入来源。未来，公司研发生产的应用于任意层HDI市场的CO₂激光钻孔机、高解析度LDI、专用高精测试机以及应用于IC载板的超高转速主轴机械钻孔机、新型激光钻孔机等高附加值产品有望成为新的业绩驱动，进一步提升公司的综合盈利能力。

二、公司所处行业情况

PCB产业发源于欧美、再转移至日韩及中国台湾地区，再在近二十年持续转移中国内地，中国2006年开始超越日本成为全球第一大PCB生产国，2016年至今PCB产值占比超过全球一半以上，2021年中国国内PCB产值占全球的比例攀升至54.2%。

公司下游客户为PCB制造商，产业链终端涵盖计算设备、通讯设备、消费电子产品、汽车电子等各类产品。近年来随着大数据、人工智能、物联网等数字经济持续发力，加上国家东数西算、汽车电动智能化、新能源及储能等政策驱动，不断涌现出各类新需求的终端产品，对PCB的技术要求越来越高，对PCB细分市场的需求则主要集中在高频高速高多层板、HDI板、封装基板，促进PCB制造企业不断的技术升级改造及企业战略重点转向HDI板、封装基板等高附加值细分市场。需求量与技术的同时提升，为PCB专用加工设备市场带来广阔的增长空间。

另一方面，PCB行业作为新兴数字产业中重要的组成部分，受到国家产业政策的大力支持。近年来，国家相关部门制定了一系列产业政策和规划，引导和推动行业的健康、持续发展。

三、公司独特的创新发展模式

行业内专用设备企业一般只聚焦于某单一或少数工序的技术，并用一项独特的技术服务于多个行业。与行业内大部分设备商不同，公司在近20年的发展中始终专注于PCB专用设备行业，凭借对高速高精运动控制、精密机械、电气工程、软件算法、先进光学系统、激光技术、图像处理、电子测试八大先进技术的综合运用，先后拓展了钻孔、曝光、成型、检测等多个PCB关键工序及多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个PCB细分市场。并且通过这种创新业务发展模式，形成

了技术、产品、应用场景、供应链、客户的多维协同。

技术协同可实现一技多用，有效避免重复研发，如先进光学系统既应用于激光直接成像系统，也应用于激光钻孔机，某一项技术的突破可迅速运用到不同设备上，实现不同产品技术的快速升级；产品协同可以让我们的尖刀产品带动其他产品的销售，为客户提供一站式设备供应，大量节约客户的采购成本；应用场景协同则可为客户快速提供不同场景下的关键设备，如 24.5×43 英寸大尺寸排版工艺，公司从前工序的钻孔到后工序的成型，同时立项研发对应的加工设备来满足客户需要；供应链协同形成的规模化采购优势，可有效控制产品品质的稳定性和成本；通过PCB行业龙头客户的示范效应，如超大通讯背板通用测试机，实现众多通讯背板生产厂商的销售，达到良好的客户协同效果。

通过多维协同、相互促进，不断提升公司产品的技术能力，使得公司以最经济的投入产生最大的效益并形成良性循环，公司有更多的资源投入到更多创新型解决方案的研发，为国内PCB产业的整体进步提供动能，不断践行“成为行业最受尊敬和信赖的PCB装备服务商”的理念。

四、多层板市场业务情况

公司在多层板市场营收占比较高，且具有较强的综合经营能力。公司将持续深耕该市场，为超大尺寸排版带来的人工作业困难问题，提供整套自动化解决方案；另一方面也将继续推进LDI替代传统菲林曝光机。

针对服务器、通讯设备等终端的高多层板，公司推出CCD六轴独立机械钻孔机、高层间对位精度LDI、大台面通用测试机及高精度CCD四线测试机等产品，大幅提升了背钻孔加工的精度及成品的可靠性。

五、公司在HDI、IC封装载板领域的规划

在HDI、IC封装载板市场方面，通讯设备、服务器、新能源汽车及自动驾驶、可穿戴等对高附加值PCB需求增加，加上该类产品的设备投入产出比相对较低，PCB企业需要大幅增加对专用设备的采购。

公司研发的CO₂激光钻孔机、高解析度LDI、专用高精测试机等产品能完全满足常规HDI产品的生产需求且具有较高的性价比，在国内多家HDI客户实现批量销售。另外，此类产品均可延伸至任意层HDI市场，并已在客户端取得认证。

针对IC封装载板，公司正积极推动新研发的超高转速主轴机械钻孔机、新型激光钻孔机等多款产品在客户端的认证，配合客户新产品研发及设备评估要求，对产品进行了多项优化，以保证产品在客户端认证的顺利进行。

六、公司上半年订单情况

上半年受新冠疫情影响，公司订单交付有一定程度延缓，具体经营情况请关注公司后续 2022 年半年度报告。

新冠疫情持续、国际地缘政治恶化对全球经济造成了一定的影响，电子终端产品市场需求较为低迷，致使PCB产业的产能扩充减缓，对公司

	经营带来一定压力。但是高技术附加值设备需求紧迫度的降低，为公司新产品研发及高端市场产品在客户端认证赢得了宝贵的窗口期。公司积极把握PCB细分市场发展机遇，聚焦市场增速快、技术门槛更高的HDI板、IC封装基板等领域，不断加大产品研发投入，提升设备性能，为未来进一步拓展市场夯实基础。
附件清单（如有）	无
日期	2022年7月15日